

IC PCB Technics Capacity

No.	アイテム	説明	データシート
1	Sheng Yi	Core/P.P	SI643HU, SI10U, SI09U, SI07U, SI05U
2	Mitsubishi Gas Chemical	Core/P.P	HL832NXA, HL832NS, HL832NSR(LC)
3	DooSan	Core/P.P	DS-7409HGB(S), DS-7409HGB(LE), DS-7409HGB(X)
4	パナソニック	Core/P.P	R1515E/R1515H
5	穴からトレースまでの最短距離 (ブラインド/埋没穴)	Core/P.P	E679FGB, E770G(LH), BT-NSF(LCA)
6	穴からトレースまでの最短距離 (レーザードリル、1または2ステップ)	Layer	1-16層
7	外層のビアホールパッドの最小片面幅 外層	um	25
8	「アウトライン配線時の 外形配線時	um	25
9	最大絶縁抵抗 (テスト用)	um	80
10	穴抵抗試験基板厚さ限界	um	250
11	穴抵抗試験開口限界	um	80
12	イオン土壌	um	80/30
13	銅剥離強度	um	200/50/20
14	抵抗溶接硬度	um	240/50/20
15	抵抗	um	330/50/20

IC PCB Technics Capacity

16	ソルダーマスクの色		Green,Black
17	ソルダーレジスト		EG23A, AUS308, AUS320, AUS410
18	表面処理		軟質金メッキ、硬質金メッキ、ENIG、OSP
19	平坦度	um	5max
20	最小穴径	wn	100
21	最小レーザー穴サイズ	um	50
22	最小厚み公差	um	30
23	最小PP	um	25
24	最小コア	um	40
25	最小フィンガーセンター距離	um	65
26	最小パラポジション精度	um	15
27	サポートプロセス		減算プロセス、mSAPプロセス
28	ソルダーレジスト公差	um	5